

プローブカード穴あけ加工の高速化の開発

開発のねらい

プローブカード穴あけ加工アルゴリズムの変更による加工高速化の実現

開発の概要

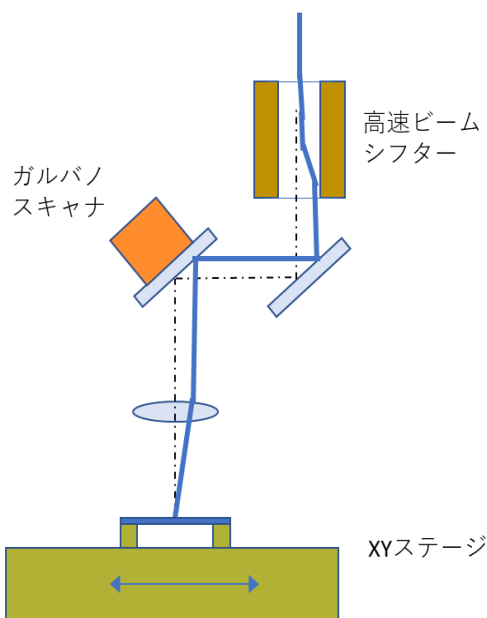
レーザ加工においてスループットの壁をブレイクスルーするために、従来までの加工アルゴリズムを見直し今まで積み上げてきた加工技術をベースに加工品質とスループットを両立できる新たな加工アルゴリズムを構築した。

特長

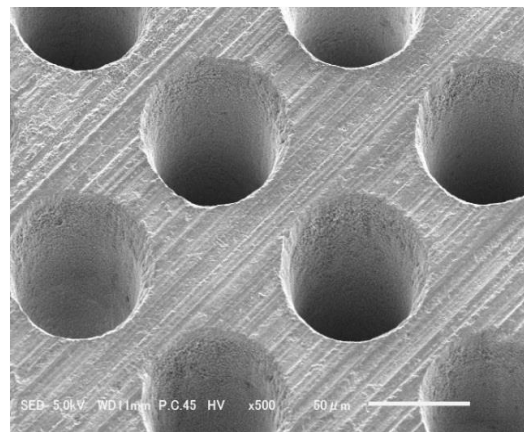
今回の新規開発ではビームシフターと5軸ガルバノスキャナの組み合わせを採用した。ビームシフターによりビームが光学系の中心からずれるため、加工物にある角度をもつビームが入射しストレート穴を形成すると同時に走査ミラーが軽量のため従来工法の2倍以上の高速化を実現することができた。

用途

プローブカード用ガイドプレート

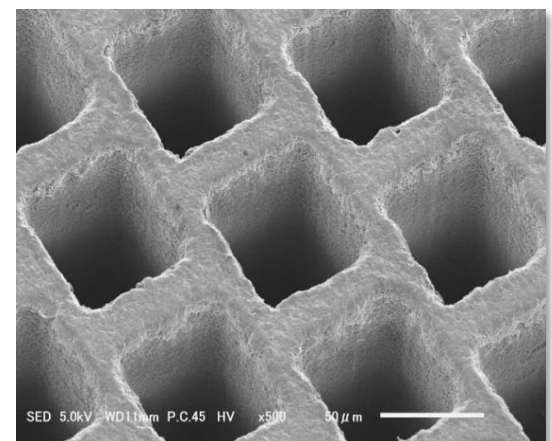


新スキャナシステム



Φ50μmストレート穴

□40μmストレート穴



お問い合わせ先

【所在地】 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1224-4

【連絡先】 TEL 048-422-4170 FAX 048-422-4175 開発G 大江

<http://www.laserjpb.co.jp/>

